

| Rückfragen an [Ansprechpartnerin Sandra Lange](#)

Wirtschaftsförderung | Veranstaltung | Forschung/Technologie | Wirtschaft

Sächsisch-japanischer Workshop: Zusammenarbeit in der Mikroelektronik vertieft

Das vielfältige Know-how und die breite Expertise sächsischer und japanischer Forschungsinstitute, Hochschulen und Unternehmen in der Mikroelektronik standen im Mittelpunkt des gemeinsamen Workshops der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) mit den Universitäten Yamagata und Tohoku, der heute mit rund 60 Teilnehmern im japanischen Sendai stattfand. Neben dem intensiven Austausch zur »Nächsten Generation Halbleiter« ging es vor allem um den Ausbau und die Vertiefung der Zusammenarbeit. Der Workshop ist Teil der Delegationsreise von Wirtschaftsminister Martin Dulig nach Japan.

Sachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig: »Hier in Sendai, wo vor kurzem noch die G7-Wissenschaftsminister tagten, schlägt das Herz der japanischen Mikroelektronik-Forschung. Wir alle tragen gemeinsam Verantwortung für unsere Welt. Dafür braucht man vor allem zwei Dinge: das eigene Verhalten und technische Innovationen. Die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind gemeinsame Herausforderungen. Deshalb ist es gut und lohnenswert zusammenzuarbeiten und die Stärken des anderen zu nutzen. Die Stärken, die sich hier in Japan, in Sendai, entwickelt haben und die Stärken die wir mitgebracht haben, können sich gut ergänzen. Gerade in der Mikroelektronik sollten wir diese Stärken nutzen. Dafür haben wir unsere Kompetenz aus Sachsen heute hier in Sendai mit dabei, Wissenschaftler, Forscher, Unternehmer und politische Vertreter.«

»Mit der heutigen Veranstaltung knüpfen wir an den gemeinsamen Online-Workshop im Februar dieses Jahres an. Sachsen präsentierte sich für die Mikroelektronikbranche erneut als attraktiver Kooperationsstandort und »Technologie-Hub« zwischen Japan und Europa. Die japanischen Vertreter haben sich einmal mehr als sehr präzise und zuverlässig und damit als gute Forschungs- und Entwicklungspartner vorgestellt. Nach wie vor wird in Japan trotz digitaler Kommunikation ein persönlicher Anfangskontakt als Schlüssel für Kooperationen und Geschäftsbeziehungen angesehen. Diese Möglichkeit haben die Teilnehmer intensiv genutzt und wir freuen uns, dass wir die Kooperation zwischen den Universitäten und Instituten sowie Unternehmen weiter voranbringen konnten«, erklärte WFS-Geschäftsführer Thomas Horn.

Fachlicher Austausch auf Augenhöhe

Im Rahmen des Workshops stellte die Tohoku Universität, die in Japan als Schlüsseluniversität bei der Entwicklung der Mikroelektronik gilt, ihre Forschungsaktivitäten im Bereich neuartige Elektronik auf Silizium-Basis für KI-optimierte Rechner und CMOS-Bildsensortechnologien vor. Für die Repräsentantin

des neuen Sonderforschungsbereiches »HYP*MOL– Hyperpolarisation in molekularen Systemen« der Universität Leipzig und der TU Chemnitz gab es die Gelegenheit, erste Kontakte für eine perspektivische Zusammenarbeit mit dem Center for Innovative Integrated Electronic Systems (CIES) des renommierten Professor Tetsuo Endoh zu knüpfen.

Die TU Chemnitz kann bereits auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Tohoku Universität aufbauen. Die Partnerschaft von Chemnitzer Einrichtungen in der Mikrochip-Integration sowie der Verbindung von Sensor- und Auswerteelektronik wurde durch die Teilnahme der TU Chemnitz und des Fraunhofer Instituts für Elektronische Nanosysteme (ENAS) als Teil der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland gestärkt und soll auf weitere Arbeitsgebiete ausgeweitet werden.

Die Yamagata Universität wiederum hat einen Fokus auf organische Elektronik, also elektronischen Bauelementen auf der Basis von Kohlenstoffketten, wie sie in der Natur vorkommen. Hier arbeitet man langjährig mit der TU Dresden zusammen. Die beiden Universitäten kooperieren in dem Projekt »FLEXMONIRS« (Miniaturized full-organic spectroscopic NIR-OLED-sensor-systems) unter Einbindung des jungen sächsischen Unternehmens Senorics, das sich auf gedruckte Sensoren auf Basis organischer Elektronik spezialisiert hat. Die Projektpartner nutzen die Delegationsreise für einen eigenen Entwicklungsworkshop.

Von sächsischer Seite präsentierten sich zudem die Dresdner Fraunhofer-Institute für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP und für Integrierte Schaltungen-Entwicklung Adaptiver Systeme IIS-EAS sowie die Professur für angewandte Physik und photonische Materialien der TU Dresden.

Aus Unternehmensicht berichteten die zum Teil noch jungen japanischen Unternehmen MEMS CORE, inspec, Power Spin und Tohoku-Microsystems u.a. über aktuelle Entwicklungen in der 3D-Integration von elektronischen Bauelementen. Aus den Bereichen neuromorpher Computerchips, integrierter KI Technologien, organischer Sensorik und Oberflächenwellen-Halbleiter sowie Kältetechnik informierten Vertreter der sächsischen Unternehmen Senorics, Linguwerk, SpiNNcloud Systems, Sachsen-Kälte und SAW COMPONENTS Dresden die Teilnehmer.

Links:

[WFS-Veranstaltungskalender](#)

[Anmeldung zum WFS-Newsletter](#)